

SEMI-FLUID MOLD RELEASE COMPOUND

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

<u>Артикул</u>	<u>71950</u>
Кажущаяся вязкость (Brookfield) по ASTM D2196 при 25°C (77°F), сП	2800
Тип загустителя	Органоглина
Вязкость (базовая жидкость), ASDM D445 при 40°C, сСт при 100°C, сСт	113 11,8
Вязкость (базовая жидкость), ASDM D2161 при 100°F, SUS при 210°F, SUS	592 67,0
Растворитель	Уайт-спирит
Температура вспышки (Базовая жидкость), ASTM D93, °C (°F)	43 (109)
Внешний вид	Полужидкий
Цвет	Желтовато-коричневый

Следует проявлять **осторожность** при использовании уайт-спирита. Это горючий растворитель и его необходимо применять в хорошо проветриваемом помещении и держать подальше от огня. После нанесения **Semi-Fluid Mold Release Compound** необходимо подождать какое-то время до испарения растворителей. Требуемое время будет зависеть от таких факторов, как толщина пленки, температура окружающей среды и циркуляция воздуха.